

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 27 年 10 月 15 日 (2015.10.15)

【公開番号】特開 2013-61328 (P2013-61328A)

【公開日】平成 25 年 4 月 4 日 (2013.4.4)

【年通号数】公開・登録公報 2013-016

【出願番号】特願 2012-193653 (P2012-193653)

【国際特許分類】

G 0 1 T 3/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 T 3/00 A

G 0 1 T 3/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 8 月 31 日 (2015.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ホウ素コーティングを中性子検出器の面上に堆積させる方法であって、
前記中性子検出器の導電面を用意するステップと、
前記中性子検出器の前記導電面に、前記中性子検出器の前記導電面にわたるホウ素コーティングをもたらすホウ素含有粉末を静電噴霧するステップとを含む方法。

【請求項 2】

前記中性子検出器の導電面を用意する前記ステップが、微細特徴が前記導電面上に位置する前記導電面を用意するステップを含み、前記中性子検出器の前記導電面に、ホウ素含有粉末を静電噴霧する前記ステップが、前記導電面上に位置する前記微細特徴に適合する、前記導電面にわたるホウ素コーティングをもたらす、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記導電面に対する結合剤の塗布をさらに含む、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記ホウ素コーティングの厚さが、2 から 5 ミクロンの間である、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 5】

前記ホウ素コーティングの厚さが、3 から 4 ミクロンの間である、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 6】

前記ホウ素含有粉末が、重量単位で約 97 % の最小の総ホウ素含有量、および、重量単位で約 98 % の、前記総ホウ素含有量に対する最小の比の ^{10}B 同位体を含む、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 7】

前記ホウ素コーティングが、ホウ素の 1 グラムあたり 7.00×10^{-4} グラム未満の可溶性残留物の、前記ホウ素と混合された所定の量の可溶性残留物を含む、請求項 2 に記載の方法。

